

## 概 要

本概要旨在向閣下提供本文件所載資料的概覽。由於其屬概要，因此並無載入可能對閣下屬重要的所有資料。閣下決定投資[編纂]前，務請閱畢本文件。

任何投資均附帶風險。投資於[編纂]的部分具體風險載於本文件「風險因素」一節。閣下決定投資[編纂]前，務請審慎閱覽該節。

### 業務概覽

本集團產銷離散式功率半導體，以旗下「PFC」品牌進軍中國、台灣及其他亞洲地區市場。離散式半導體是執行基本電子功能的個別半導體元件，而離散式功率半導體一般內置整流器<sup>(附註1)</sup>及晶體管<sup>(附註2)</sup>，為一種轉換交流電的離散式半導體，並為電子器材及電器的常用元件。往績記錄期間，本集團的離散式功率半導體涵蓋蕭基二極管(一種轉化交流電為僅單向流通的整流器)及金屬氧化半導體場效晶體管(「MOSFET」，一種用於放大及調制電子訊號及電力的晶體管)。有關本集團業務及其產品的進一步詳情，請參閱本文件「業務一概覽」一節。本集團的離散式功率半導體應用於電源供應器，應用範圍遍及多種電子器材，達至供電節能效果，從而提高電子器材的能源效益。本集團亦從事原材料(即磊晶(「EPI」))貿易業務。本集團採購EPI作為其主要原材料，該半導體材料為生產加工半導體材料(「晶圓」)<sup>(附註3)</sup>的核心原材料。本集團出售其部分EPI予中國晶圓代工廠公司，該公司是位於中國深圳的晶圓代工廠，於往績記錄期間內為本集團五大供應商之一，其於截至2016年3月31日止三個月亦為本集團五大客戶之一。有關往績記錄期間內中國晶圓代工廠公司以及本集團與中國晶圓代工廠公司的交易的進一步詳情，請參閱本文件「業務一客戶一原材料貿易」一節。

本集團旗下研發團隊設於台灣，並主要以改善產品性能、開發新產品及技術為重心。本集團的離散式功率半導體使用由本集團內部研發團隊開發的自有專利元件結構及製造方法。於最後實際可行日期，本集團持有在美國、台灣及中國就其離散式功率半導體的元件結構及／或製造方法註冊的46項專利。

附註：

1. 整流器為一種通過只允許電流單向流通而轉化交流電為直流電的半導體元件。
2. 晶體管為一種用於放大及調制電子訊號及電力的半導體元件。
3. 硅晶等薄片半導體材料，於晶圓加工廠進行的晶圓加工流程中加工為列陣集成電路或離散式元件。

## 概 要

本集團在位於中國廣東順德的順德生產廠房製造其大部分產品。於離散式功率半導體製造流程中，本集團於順德生產廠房進行製造流程中的封裝及測試流程，並向外聘晶圓加工廠外判晶圓加工流程。本集團亦向外聘封裝公司外判若干封裝類型的離散式功率半導體的封裝流程。於最後實際可行日期，本集團在順德生產廠房有合共94名僱員。本集團在台灣及香港經營業務辦事處，銷售後勤辦事處則位於中國深圳。台灣銷售辦事處監督本集團的銷售及營銷業務。本集團離散式功率半導體大多售予分銷商，彼等則轉售予本集團產品的直接用家，即主要為電源供應器製造商，電源供應器將於其後用於多種電子器材。

本集團的收入自截至2014年12月31日止年度約16.2百萬美元增至截至2015年12月31日止年度約18.1百萬美元，增幅相當於約11.6%或1.9百萬美元。截至2016年3月31日止三個月，本集團錄得收入約5.6百萬美元，較上年同期增加約52.0%或1.9百萬美元。本集團的毛利率維持穩定，截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月分別約為28.4%、28.5%及30.0%。

下表所載為往績記錄期間按業務分部劃分的本集團收入詳情：

	截至2014年 12月31日止 年度		截至2015年 12月31日止 年度		截至2015年 3月31日止 三個月		截至2016年 3月31日止 三個月	
	千美元	%	千美元	%	千美元	%	千美元	%
	(未經審核)							
離散式功率半導體銷售	15,112	93.2	16,694	92.3	3,164	85.7	5,113	91.1
原材料貿易	1,109	6.8	1,401	7.7	528	14.3	498	8.9
<b>總計</b>	<b>16,221</b>	<b>100.0</b>	<b>18,095</b>	<b>100.0</b>	<b>3,692</b>	<b>100.0</b>	<b>5,611</b>	<b>100.0</b>

下表所載為往績記錄期間按分銷地區劃分的本集團收入地域詳情：

	截至2014年 12月31日止 年度		截至2015年 12月31日止 年度		截至2015年 3月31日止 三個月		截至2016年 3月31日止 三個月	
	千美元	%	千美元	%	千美元	%	千美元	%
	(未經審核)							
台灣	6,744	41.6	7,649	42.3	1,740	47.1	2,616	46.6
中國(附註1)	8,267	51.0	9,662	53.4	1,835	49.7	2,764	49.3
亞洲，中國及台灣除外 (附註2)	1,210	7.4	784	4.3	117	3.2	231	4.1
<b>總計</b>	<b>16,221</b>	<b>100.0</b>	<b>18,095</b>	<b>100.0</b>	<b>3,692</b>	<b>100.0</b>	<b>5,611</b>	<b>100.0</b>

## 概 要

附註：

1. 包括(i)向中國晶圓代工廠公司銷售EPI；及(ii)向蜆壳多媒體集團銷售離散式功率半導體。
2. 亞洲區(中國及台灣除外)所得收入主要來自向韓國分銷商的銷售。

下表所載為截至2015年12月31日止兩個年度內按封裝類型劃分的本集團主要產品蕭基二極管的收入、銷量及平均售價：

封裝類型	截至12月31日止年度								2014年至 2015年間 平均 售價減幅
	2014年				2015年				
	收入	收入%	已售件數	平均 售價	收入	收入%	已售件數	平均 售價	
	千美元		千	每千件 美元	千美元		千	每千件 美元	%
TO-220	8,650	57.2%	49,942	173	9,695	58.1%	58,784	165	4.8%
ITO-220	1,989	13.2%	9,478	210	2,832	17.0%	16,834	168	19.8%
TO-277	2,235	14.8%	20,772	108	2,224	13.3%	24,820	90	16.7%
TO-247	492	3.2%	1,154	427	477	2.9%	1,668	286	32.9%
SMAF-A	404	2.7%	9,407	43	232	1.4%	6,904	34	21.9%
其他	1,342	8.9%	不適用	不適用	1,234	7.3%	不適用	不適用	不適用
總計	15,112	100.0%	—	—	16,694	100.0%	—	—	—

下表載列截至2015年及2016年3月31日止三個月按封裝類型劃分的蕭基二極管的收入、銷量及平均售價：

封裝類型	截至3月31日止三個月								期間平均 售價減幅/ (增幅)
	2015年				2016年				
	收入	收入%	已售件數	平均 售價	收入	收入%	已售件數	平均 售價	
	千美元 (未經審核)		千	每千件 美元	千美元		千	每千件 美元	%
TO-220	1,931	61.1%	10,728	180	3,085	60.4%	18,379	168	6.8
ITO-220	573	18.1%	3,034	189	1,202	23.5%	7,046	171	9.6
TO-277	300	9.5%	2,810	107	280	5.5%	3,699	76	29.2
TO-247	165	5.2%	636	259	99	1.9%	366	272	(4.9)
SMAF-A	17	0.5%	310	55	7	0.1%	178	42	24.1
其他	178	5.6%	不適用	不適用	440	8.6%	不適用	不適用	不適用
總計	3,164	100.0%	—	—	5,113	100.0%	—	—	—

## 概 要

董事認為，半導體市場定價具透明度，而本集團產品的平均售價與業內相若。2015年本集團離散式功率半導體主要封裝類型平均售價較上一年度降價約4.8%至32.9%，而截至2016年3月31日止三個月則較上年同期減少約6.8%至29.2%（封裝類型TO-247除外），董事認為，主要由於(i)全球及中國離散式半導體市場的平均售價趨降；及(ii)本集團產品組合有變。有關平均售價等本集團產品的進一步詳情，請參閱本文件「業務—本集團產品」一節。本集團曾對其離散式功率半導體的平均售價進行7%上調／下調的敏感度分析，此乃基於截至2015年12月31日止兩個年度之間本集團離散式功率半導體五大封裝類型的平均售價整體減幅以及對往績記錄期間本集團毛利及純利的相應影響，僅供說明用途如下，有關進一步詳情，請參閱本文件「財務資料—經營業績主要組成部分—敏感度分析」一節。

	截至2014年12月31日止		截至2015年12月31日止		截至2016年3月31日止		
	年度		年度		三個月		
	增加／ (減少) 百分比	毛利 增加／ (減少) 千美元	年度利潤 增加／ (減少) 千美元	毛利 增加／ (減少) 千美元	年度利潤 增加／ (減少) 千美元	毛利 增加／ (減少) 千美元	期間虧損 減少／ (增加) 千美元
平均售價	7% (7%)	1,135 (1,135)	948 (948)	1,267 (1,267)	1,058 (1,058)	393 (393)	328 (328)

## 概 要

下表所載為往績記錄期間主要離散式功率半導體封裝類型的產能上限、實際產量及利用率的資料：

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月		
	2014年			2015年			2016年		
	產能上限 (附註)	實際 產量	平均 利用率	產能上限 (附註)	實際 產量	平均 利用率	產能 上限 (附註)	實際 產量	平均 利用率
千件	千件	%	千件	千件	%	千件	千件	%	
晶圓測試及 分類：	220,440	155,003	70.3	207,240	170,523	82.3	52,140	31,155	59.8
封裝： (晶粒切割) TO220/ITO220 /TO277/TO247 (固晶) (線焊)	169,004	157,841	93.4	238,326	190,321	79.9	59,961	42,684	71.2
	94,422	90,279	95.6	145,402	107,401	73.9	42,290	31,063	73.5
	93,687	88,509	94.5	132,878	106,753	80.3	42,320	30,843	72.9
SMAF-A (固晶及線焊)	—	—	—	82,896	6,890	8.3	20,856	298	1.4
產品測試：									
1. TO220/ITO220	73,480	63,328	86.2	105,050	78,132	74.4	34,760	27,247	78.4
2. TO277	49,232	21,587	43.8	79,301	26,940	34.0	23,289	3,888	16.7
3. TO247	1,540	596	38.7	17,270	1,609	9.3	4,345	407	9.4
4. SMAF-A	—	—	—	46,284	6,520	14.1	11,645	267	2.3

附註：年產能上限按(i)各設備的設計日產能；及(ii)截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月分別為334、314及79個營運日計算。

截至2015年12月31日止年度，本集團主要離散式功率半導體封裝類型的實際產量較上一年度增加，主要由於藉添置全新生產設備擴充產能。有關往績記錄期間內本集團生產設備利用率的進一步詳情，請參閱本文件「業務—生產設施及產能—生產設備」一節。

就原材料貿易而言，截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月，向中國晶圓代工廠公司的EPI銷售分別約為1.1百萬美元、1.4百萬美元及0.5百萬美元，分別相當於本集團收入約6.8%、7.7%及8.9%，銷量約達22,000件、28,000件及10,000件EPI(每件直徑六吋)。有關往績記錄期間中國晶圓代工廠公司以及本集團與中國晶圓代工廠公司之間的交易的進一步詳情，請參閱本文件「業務—客戶—原材料貿易」一節。

---

## 概 要

---

### 客戶及供應商

截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月，本集團五大客戶分別佔收入總額約57.1%、61.8%及67.2%。五大客戶並無責任在日後以任何方式繼續向本集團提供與過往水平相若的新業務，或完全不會提供新業務。儘管客戶集中，董事認為，由於本文件「業務—客戶—客戶集中度」一節所載理由，本集團並無依賴任何單一客戶。

截至2015年12月31日止兩個年度以及截至2016年3月31日止三個月，本集團五大供應商分別約佔其採購總額78.4%、78.5%及82.8%。儘管供應商集中，董事認為，由於本文件「業務—供應商—供應商集中度」一節所載理由，本集團並非依賴任何單一供應商。

本集團的銷售團隊與本集團的分銷商合作以推廣本集團的產品，包括產品培訓及簡報，並與最終用家合作為本集團產品取得認證，及成為最終用家的認可供應商。凡本集團客戶（即分銷商）所採購的有關元件將於該等最終用家產品最終採用的，其一般須自最終用家獲認可供應商名單的獲認可供應商（例如本集團）採購元件。有關本集團銷售及營銷策略以及與分銷商關係的進一步詳情，請參閱本文件「業務—銷售及營銷」及「業務—客戶」兩節。

本集團的客戶主要為非獨家分銷商，彼等繼而轉售本集團的半導體產品予本集團產品的直接用家，即主要為電源供應器製造商，電源供應器將於其後用於多種電子器材。一般而言，本集團與各分銷商訂立具法律約束力非獨家分銷協議，以規管本集團產品於特定地區的分銷。典型分銷協議的主要條款包括(i)規管協議期限的協議年期、重續及終止條款；(ii)訂明分銷地區及其持續義務的分銷商責任條款；(iii)規管分銷商進行採購的交易程序條款；(iv)規管定價基準的採購訂單條款；(v)信貸條款期；及(vi)規管退貨程序的退貨及保修條款。

### 競爭態勢

本集團產銷離散式功率半導體，在全球離散式半導體製造價值鏈中的一環開展競爭。全球離散式半導體製造價值鏈由產品設計、晶圓加工、測試及封裝組裝組成。本集團於順德生產廠房進行製造流程中的設計及測試流程以及大部分封裝流程，並向外聘晶圓加工廠外判晶圓加工流程。全球離散式半導體市場主要由數十年來主導市場的跨國公司控制，市場份額集中度高，中國（包括香港）半導體市場亦是如此。根據Prismark，中國離散式半導體市場於2015年在全球市場價值中約佔32.6%，而按2015年收入計，全球五大及十大離散式半導體供應商分別約佔全球離散式半導體產量的37.3%及60.7%，而中國五大及十大離散式半導體供應商分別約佔中國離散式半導體產量的58.7%及73.3%。2015年，本公司收入分別約佔全球及中國離散式半導體市場0.1%及0.3%。儘管

---

## 概 要

---

在全球市場及中國市場(i)全球及中國的十大市場參與者，一直持續分佔總產量逾半，以致所售產品選擇有限的較小型參與者難以開拓市場；及(ii)2015年第四季，全球及中國市場參與者普遍產能約為75–85%，而進一步改善供應來源產能利用率的需要使市場參與者之間的競爭更形激烈，但由於市場上最終用家數目眾多，因此仍然不乏商機。有關離散式半導體市場競爭態勢的進一步詳情，請參閱本文件「行業概覽—市場參與者及競爭態勢」一節。

### 競爭優勢

董事相信，本集團的成功可歸因於(其中包括)以下競爭優勢：(i)作為離散式功率半導體製造商質量卓越美譽度高；(ii)研發實力專注精誠助力產品開發改善；(iii)先進生產線與深厚技術專長相輔相承；及(iv)管理團隊實力雄厚表現穩定，業內經驗廣泛豐富。有關本集團競爭優勢的進一步詳情，請參閱本文件「業務—競爭優勢」一節。

### 資產重組

截至2015年12月31日止兩個年度，本集團產品的製造大部分由SDMM節能元件分部於順德生產廠房進行，該部門為順德多媒體部門之一，於2011年成立以製造離散式功率半導體。順德多媒體為控股股東之一及本公司關連人士蜆壳電器的間接全資附屬公司。根據於2015年12月31日完成的資產重組，順德多媒體向節能元件(廣東)轉讓SDMM節能元件分部有關生產離散式功率半導體的所有生產資產。為澄清起見，SDMM節能元件分部概無根據資產重組向節能元件(廣東)轉讓任何負債。本集團亦租用順德生產廠房作為其生產設施。資產重組完成後，離散式功率半導體製造由節能元件(廣東)承接。有關資產重組的進一步資料，請參閱[編纂]「歷史、重組及公司架構—資產重組」一節。

本集團截至2015年12月31日止兩個年度合併財務資料乃自蜆壳電器的綜合財務報表按分拆法編製，以供呈列半導體業務的財務狀況、經營業績及現金流量，主要通過節能元件控股及其附屬公司以及SDMM節能元件分部(該部門為順德多媒體部門之一)進行。節能元件控股及順德多媒體均由蜆壳電器擁有及控制。因此，財務資料已經合併節能元

## 概 要

件控股及其附屬公司的財務報表以及SDMM節能元件分部的財務報表而編製，並已參考香港會計師公會頒佈的香港會計指引第5號—共同控制合併的合併會計處理項下的合併會計處理原則。

### 財務資料

下表所載為本集團合併全面收益表的選定資料及分析：

#### 往績記錄期間經營業績

	截至12月31日止年度		截至3月31日止三個月	
	2014年	2015年	2015年	2016年
	千美元	千美元	千美元	千美元
收入	16,221	18,095	3,692	5,611
毛利	4,610	5,164	1,151	1,686
除所得稅前利潤／(虧損)	1,739	1,136	180	(62)
年度／期間利潤／(虧損)	1,556	687	59	(222)

本集團的收入及毛利於截至2014年12月31日止年度至截至2015年12月31日止年度間分別增加約11.6%及12.0%，主要由於本集團的封裝類型TO-220及ITO-220產品需求更形殷切，分別錄得約1.0百萬美元及[編纂]百萬美元的銷售增長。本集團除所得稅前利潤於截至2014年12月31日止年度至截至2015年12月31日止年度減少約34.7%，主要由於(i)因員工成本隨人手增加而上漲、因獎勵若干管理層對本集團截至2014年12月31日止年度財務業績的貢獻產生股份支付開支、台灣辦工室用途租金開支增加以及自年內添置物業、廠房及機器產生(其中以租賃裝修尤其顯著)的折舊開支增加，以致行政開支增長約[編纂]百萬美元；及(ii)其他經營開支增加約0.5百萬美元，當中約[編纂]美元乃上市開支。本集團於截至2014年12月31日止年度至截至2015年12月31日止年度年內利潤減少約55.8%，主要由於上文所述原因及截至2015年12月31日止年度所得稅開支增加0.3百萬美元。

收入自截至2015年3月31日止三個月約3.7百萬美元增加約52.0%或1.9百萬美元至截至2016年3月31日止三個月約5.6百萬美元。該增加主要由於本集團持續致力鞏固其與分銷商的關係，導致銷售離散式功率半導體所得收入有所增加。毛利自截至2015年3月31日止三個月約1.2百萬美元增加約46.5%或0.5百萬美元至截至2016年3月31日止三個月約1.7百萬美元，主要與收入增加一致。本集團於截至2015年3月31日止三個月錄得除所得



## 概 要

稅前利潤及純利，但於截至2016年3月31日止三個月錄得除所得稅前虧損及淨虧損，主要源於自截至2016年3月31日止三個月自損益扣除上市開支約[編纂]美元，而上年同期則並無產生該等項目。

下表所載為本集團合併財務狀況表選定資料：

	於12月31日		於3月31日
	2014年	2015年	2016年
	千美元	千美元	千美元
流動資產	6,732	11,598	24,987
流動負債	(10,736)	(16,103)	(24,709)
非流動資產	7,724	9,990	10,255
非流動負債	—	14	(5,000)
流動(負債)／資產淨額	(4,004)	(4,505)	278
權益總額	3,720	5,471	5,533

本集團的權益自2014年12月31日約3.7百萬美元增至2015年12月31日的約5.5百萬美元，主要由於SMC Multi-Media Products的資本出資約1.2百萬美元及年內利潤約[編纂]百萬美元所致。流動負債淨額自2014年12月31日的約4.0百萬美元增至2015年12月31日的約4.5百萬美元，主要由於應付同系附屬公司款項增加至約3.2百萬美元。

本集團於2016年3月31日的財政狀況有所改善，並錄得流動資產淨額約0.3百萬美元，主要受惠於現金及銀行結餘增加約12.6百萬美元，並由於應付最終控股公司款項增加約6.7百萬美元部分抵銷。

有關應付同系附屬公司款項的償還／結算詳情，請參閱本文件「財務資料—流動(負債)／資產淨額」一節。

## 概 要

下表所載為本集團合併現金流量表選定資料：

	截至12月31日止年度		截至3月31日止三個月	
	2014年	2015年	2015年	2016年
	千美元	千美元	千美元 (未經審核)	千美元
經營活動所得／(所用)				
現金淨額	1,189	(761)	752	963
投資活動所用現金淨額	(2,892)	(3,628)	(1,985)	(530)
融資活動所得現金淨額	<u>871</u>	<u>6,262</u>	<u>1,366</u>	<u>12,184</u>
現金及現金等價物(減				
少)／增加淨額	(832)	1,873	133	12,617
年／期初現金及現金等價物	1,807	946	946	2,806
滙率變動影響	<u>(29)</u>	<u>(13)</u>	<u>7</u>	<u>15</u>
年／期末現金及現金等價物	<u><u>946</u></u>	<u><u>2,806</u></u>	<u><u>1,086</u></u>	<u><u>15,438</u></u>

包括銀行結餘及現金的現金及現金等價物自2014年12月31日約0.9百萬美元增至2015年12月31日約2.8百萬美元。增加主要由於融資活動所得現金淨額約6.3百萬美元，當中包括(i)應付同系附屬公司款項增加約4.6百萬美元；及(ii)銀行借款淨額增加1.6百萬美元，並由購置物業、廠房及設備約3.7百萬美元以及經營活動所用現金淨額約0.8百萬美元部分抵銷。

現金及現金等價物於2016年3月31日進一步增至約15.4百萬美元。增加主要由於融資活動所得現金淨額約12.2百萬美元，當中包括(i)應付最終控股公司款項增加約6.7百萬美元；及(ii)銀行借款增加6.4百萬美元，並由償還銀行借款約1.6百萬美元部分抵銷。

截至2015年12月31日止兩個年度，本集團除營運資金變動前經營利潤分別約2.5百萬美元及2.4百萬美元。截至2015年12月31日止年度，經營現金流出淨額約0.8百萬美元，主要為存貨增加約0.3百萬美元以及貿易及其他應收款項、按金及預付款增加約3.1百萬美元所致。

## 概 要

截至2016年3月31日止三個月，本集團除營運資金變動前經營利潤約0.5百萬美元，而本集團錄得經調整營運資金變動後經營活動所得現金淨額約1.0百萬美元，主要包括(i)貿易及其他應付款項增加約1.3百萬美元，及(ii)存貨增加約0.7百萬美元。

有關本集團財務資料的進一步討論及分析，請參閱本文件「財務資料」一節。

### 主要財務比率

下表載列往績記錄期間本集團的主要財務比率。

	截至12月31日止年度		截至3月31日 止三個月
	2014年	2015年	2016年
總資產回報率 <sup>(1)</sup>	10.8%	3.2%	淨虧損
股權回報率 <sup>(2)</sup>	41.8%	12.6%	淨虧損
利息覆蓋率 <sup>(3)</sup>	80.0倍	379.7倍	淨虧損
	於12月31日		於3月31日
	2014年	2015年	2016年
流動比率 <sup>(4)</sup>	0.63	0.72	1.01
速動比率 <sup>(5)</sup>	0.36	0.54	0.87
資本負債比率 <sup>(6)</sup>	2.43	2.53	4.58

附註：

- (1) 總資產回報率按年度利潤除以年末資產總值計算；
- (2) 股權回報率按年度利潤除以年末權益總額計算；
- (3) 利息覆蓋率按年度除息稅前利潤除以同年利息開支計算；
- (4) 流動比率按年末流動資產除以流動負債計算；
- (5) 速動比率按年末流動資產減存貨除以流動負債計算；
- (6) 資本負債比率按債務總額（包括並非於日常業務過程中產生的應付款項）除以年末權益總額計算。

本集團的總資產回報率及股權回報率於2014年至2015年間有所減少，主要由於截至2015年12月31日止年度純利減少，此乃由於截至2015年12月31日止年度行政開支、其他經營開支及所得稅開支增加所致，亦由於總資產及權益增加。2015年利息覆蓋率增加的主要原因為截至2015年12月31日止年度產生較少利息開支。截至2015年12月31日止兩個

---

## 概 要

---

年度的流動比率低於1.0倍，反映本集團為淨流動負債狀況，此乃由於同系附屬公司於2014年及2015年12月31日分別墊款約9.0百萬美元及12.2百萬美元作資本投資用途。本集團的資本負債比率於2015年有所增加，主要由於自資產重組產生應付同系附屬公司款項增加。

本集團於截至2016年3月31日止三個月錄得淨虧損，主要由於期內確認上市開支所致。2016年3月31日，流動比率進一步增至約1.01倍，反映2016年3月31日的財務狀況有所改善而有流動資產淨額，有關改善受益於本集團經改善現金狀況，其主要由於融資活動。與此同時，本集團速動比率於2016年3月31日亦增至約0.87倍。2016年3月31日，資本負債比率進一步增至約4.58倍，主要由於2016年3月31日應付最終控股公司款項增加約6.7百萬美元以及非即期銀行借款增加5.0百萬美元。有關進一步詳情，亦請參閱本文件「財務資料—主要財務比率」一節。

### 往績記錄期間前累計虧損

於2014年1月1日，本集團錄得結轉累計虧損，主要由於直至2014年前過往多年持續虧損所致，而經多年經營一直好轉。截至2014年12月31日止年度前過往多年，本集團錄得虧損，主要原因在於本集團由於當時業務規模，以致毛利不足涵蓋其營運成本此一事實，故該等年度未能達致盈虧相抵。本集團截至2014年12月31日止年度錄得年度利潤約1.6百萬美元，主要推動因素計有本集團開拓離散式半導體市場的持續工作以及TO-220及TO-277產品類型的銷售分別錄得增幅約3.6百萬美元及1.2百萬美元或約69.6%及115.3%，而本集團於截至2014年12月31日止年度轉虧為盈。

### 本公司股權、首次公開發售前投資及節能元件購股權股東

緊隨[編纂]及[編纂]完成後(不計及行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權時可能發行的任何股份)，本公司將(i)由Lotus Atlantic(投資控股公司，由蜆壳電器最終擁有。蜆壳電器由Red Dynasty擁有[編纂]權益，後者繼而由翁先生擁有[編纂]權益)擁有約[編纂]權益；(ii)由節能元件購股權股東(包括(a)約[編纂]由執行董事及本集團行政總裁洪先生擁有；及(b)約[編纂]由執行董事周先生擁有)擁有約[編纂]權益；(iii)由獨立投資者擁有約[編纂]權益；及(iv)由公眾股東根據[編纂]擁有約[編纂]權益。

翁先生為本公司主席、非執行董事及控股股東。有關翁先生的背景詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層」以及「與控股股東的關係」各節。

---

## 概 要

---

### 首次公開發售前投資及節能元件購股權股東

參與首次公開發售前投資的首次公開發售前投資者（[編纂]先生除外）計有徐禹銘先生、劉順發先生及黃邱淑女士，上市時於本公司實益擁有分別約[編纂]及[編纂]的股本權益。[編纂]將於[編纂]下提呈[編纂]以供購買，且於上市後將不會擁有任何股份權益。有關彼等的投資的詳情，請參閱本文件「歷史、重組及公司架構—首次公開發售前投資」一節。根據節能元件購股權計劃，節能元件控股於2015年1月7日向節能元件購股權股東授出節能元件購股權。各節能元件購股權股東於2016年2月19日就節能元件購股權簽訂行權通知書，據此，各節能元件購股權股東根據節能元件購股權行使彼等各自的權利以按行使價每股節能元件認購股份1美元認購合共553,255股節能元件控股普通股。節能元件購股權股東（連同行使節能元件購股權前持有的權益）將於上市時實益擁有本公司約3.0%股本權益。有關節能元件購股權股東的詳情，請參閱本文件「歷史、重組及公司架構—節能元件購股權」一節。

### 風險因素

本集團的業務經營涉及若干風險，當中多項在本集團控制範圍以外。具體而言，本集團依賴少數最大供應商。較主要的風險計有(i)本集團五大客戶佔本集團收入一大部分；(ii)由於離散式封裝技術日新月異，本集團可能面對有關本集團生產機器及設備以及生產方法技術過時，繼而可能對本集團的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響；(iii)本集團未必可對本集團的產品質量開展有效競爭，從而可能導致流失客戶，並對本集團的經營及財務狀況造成不利影響；(iv)原材料成本佔本集團銷售成本一大部分，任何價格波動均可能影響本集團的盈利能力；及(v)依賴來自服務供應商的充分和及時承包服務。本集團的業務經營及進一步增長可能因未能按合理條款或完全不能籌措融資而備受限制。董事相信與本集團尤其密切相關的風險因素的詳細討論載於本文件「風險因素」一節。

### 近期發展

往績記錄期間後及直至最後實際可行日期所簽訂的離散式功率半導體銷售合同值約達10.0百萬美元。於最後實際可行日期，本集團維持業務往來關係以銷售離散式功率半導體的分銷商自2016年3月31日的14名分銷商新增兩名分銷商至16名分銷商，即本集團自2016年1月1日至最後實際可行日期期間錄得向該16名分銷商的銷售。

除上市開支外，本集團於往績記錄期間後，於綜合損益及其他全面收益表內概無任何重大非經常性項目。

---

## 概 要

---

於2016年3月14日，本集團取得定期貸款5百萬美元，為期24個月。相關融通協議所載條款規定，銀行具有凌駕性權利，可於2017年6月2日結束的承諾期後隨時要求還款。2016年9月20日，銀行把前述5,000,000美元定期貸款的承諾期自2017年6月2日延至2017年12月13日。定期貸款按倫敦銀行同業拆息加1.3%的年利率計息。本集團所有銀行融通及定期貸款由以下各項擔保(i) 蜆壳電器簽立的公司保證；及(ii) 翁先生提供的個人保證，兩者均於上市時以本集團的公司保證有條件取代。

於2016年7月31日，本集團的流動負債淨額約為4.3百萬美元。於2016年7月31日，應付最終控股公司及同系附屬公司款項約為7.9百萬美元。其中(i) 7,700,000美元根據日期為2016年9月14日的認購協議以債務資本化方式結清。當中，蜆壳電器已認購7,700,000股優先股，而節能元件控股已配發及發行7,700,000股優先股，認購價為每股優先股1美元，而蜆壳電器已指定Lotus Atlantic承購該等優先股；及(ii) 餘額將由本集團於上市前以現金方式結清。該等7,700,000股優先股將與節能元件控股所有已發行優先股具有同等權益。有關債務資本化的進一步詳情，請參閱本文件「歷史、重組及公司架構—重組」一節。

於最後實際可行日期，於2016年3月31日的全部尚未結算貿易應收款項已作其後結算，而於2016年3月31日的尚未結算貿易應付款項中約99.7%已作其後結算。2016年7月31日，於2016年3月31日的存貨中約78.4%已於其後使用或出售。

### 上市開支

包銷佣金約[編纂]分別按本公司及售股股東提呈發售[編纂]及[編纂]的比例，由本公司及售股股東分攤。上市產生的專業費用總額(不包括包銷佣金)預期約達[編纂]，將由本公司承擔。

本集團預期，屬非經常性質的上市產生專業費用總額，將約達[編纂]美元(相等於約[編纂]港元)。專業費用總額[編纂]美元中，本集團於截至2015年12月31日止年度於損益確認約[編纂]美元為開支，而截至2016年3月31日止三個月則約為[編纂]美元。本集團預期，待[編纂]完成後，將於往績記錄期間後於損益確認進一步上市開支約[編纂]美元，而約[編纂]美元將於[編纂]完成後撥充資本。董事謹此知會股東及潛在投資者，截至2016年12月31日止年度的本集團財務表現及經營業績將受有關上市的估計開支顯著影響。該等上市開支為目前估計，僅供參考，最終金額將於本集團截至2016年12月31日止年度損益扣除，而將自本集團股本扣除的金額或會有所調整。

---

## 概 要

---

### 業務策略、[編纂]的理由及所得款項用途

本集團有意藉以下方式鞏固其市場地位(i)擴充本集團的離散式功率半導體產能；(ii)繼續致力進行其研發工作；及(iii)擴充其分銷網絡。本集團將購置晶圓測試及分類、晶粒切割、固晶及線焊機等設備提升產能，包括添置第四代封裝的DFN封裝類型(QFN類封裝類型)離散式功率半導體的全新封裝生產線。本集團將通過其內部資源及在台灣的現有研發團隊持續其研發努力。本集團的現有銷售團隊將通過物色新分銷商持續擴充其分銷網絡，同時與彼等合作，發展與本集團產品直接用家／最終用家的業務關係，藉此擴大其產品在其活躍市場的最終用家中的滲透。董事目前有意應用本集團將收取的[編纂]所得款項淨額藉購買相關設備提高本集團離散式功率半導體的產能。董事認為，就(i)持續本集團研發工作；及(ii)擴展本集團分銷網絡的業務策略而言，本集團內部資源及現有主責團隊將足以執行該等策略，而執行該等策略將毋須動用[編纂]所得款項。有關進一步詳情，請參閱本文件「業務—業務策略」一節。

董事相信，股份於創業板上市將提高本集團的形象，而本集團將收取的[編纂]所得款項淨額將改善財務狀況，並將使董事可執行本文件「業務目標及所得款項用途聲明」一節所載的本集團業務計劃。董事亦認為，上市可讓本集團建立較廣濶的股東基礎，並提高其品牌認知度及知名度。本集團客戶以分銷商為主，彼等繼而轉售本集團產品予本集團產品直接用家(即主要為電源供應器的製造商)，其後將由製造商(作為最終用家)在彼等營銷全球的品牌電子產品使用。因此，上市將增進其於其他品牌電子產品製造商之間的品牌認知度及知名度，並有機會掌握使本集團產品符合資格而成為最終用家獲認可供應商的其他機遇，有關產品一般須由分銷商為該等最終用家向認可供應商採購。

此外，上市提供讓本集團開通資本市場的機會，以進行企業融資活動，協助日後業務發展。董事亦相信，本集團作為上市公司，可按較優惠條款自財務機構取得債務融資。

## 概 要

本集團將收取的[編纂]所得款項淨額經扣除上市開支後估計約達[編纂]港元。董事有意動用該等[編纂]所得款項淨額作以下用途：

最後實際 可行日期至	截至以下日期止六個月					總計	佔總所得 款項淨額 百分比
	2016年	2017年	2017年	2018年	2018年		
	12月31日	6月30日	12月31日	6月30日	12月31日		
	百萬元	百萬元	百萬元	百萬元	百萬元	百萬元	%
<b>提高本集團離散式 功率半導體的產銷， 通過以下各項：</b>							
為現有封裝設施							
購置機器	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
為DFN封裝類型							
開發全新生產線	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
為測試蕭基二極管							
購置機器	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
為測試MOSFET							
購置機器	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
本集團一般營運資金	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

董事認為本集團將收取的[編纂]所得款項淨額、本集團內部資源及可供本集團動用現有銀行融資將足以撥資本集團直至截至2018年12月31日止年度的業務計劃。

倘若本集團將收取的[編纂]所得款項淨額並非須即時用於上述用途，董事目前有意將該等所得款項淨額存入於認可財務機構持有的短期計息存款戶口。

[編纂][編纂]中，售股股東將按[編纂]提呈發售合共[編纂]。售股股東自銷售待售股份收取的所得款項淨額將約達[編纂]港元。本公司將不會自[編纂]項下由售股股東出售待售股份收取任何所得款項。



## 概 要

### 股息

往績記錄期間，本公司或現時組成本集團的附屬公司概無向其當時權益擁有人宣派任何股息，2016年3月31日後亦無建議宣派任何股息。本公司目前並無固定股息政策，並可能以現金或董事視為恰當的其他方式宣派股息。宣派任何中期股息或建議任何末期股息的決定將須經董事會批准，並視乎本文件「財務資料—股息政策」一段所述的因素而定。

### [編纂]統計數據

[編纂]	[編纂]港元
按[編纂]計算的市值(附註1)	[編纂]港元
未經審核備考經調整每股合併有形資產淨值 (附註2及3)	[編纂]港元

#### 附註：

1. 股份市值的計算乃按[編纂]港元的[編纂]，以及緊隨[編纂]及[編纂]完成後已發行[編纂]股股份計算，惟不計及(i)本[編纂]附錄四「A.有關本公司的進一步資料—5.唯一股東於2016年9月19日通過的書面決議案」一段所述，根據配發及發行股份一般授權可能須予配發及發行的任何股份，或本公司根據購回股份一般授權可能購回的任何股份；及(ii)因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權可能配發及發行的任何股份。
2. 每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值乃經作出本文件「財務資料」一節所述的調整後得出，並按每股[編纂][編纂]港元的[編纂]，以及緊隨[編纂]及[編纂]完成後已發行[編纂]股股份計算，惟不計及(i)本文件附錄四「A.有關本公司的進一步資料—5.唯一股東於2016年9月19日通過的書面決議案」一段所述，根據配發及發行股份一般授權可能須予配發及發行的任何股份，或本公司根據購回股份一般授權可能購回的任何股份；及(ii)因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權可能配發及發行的任何股份。
3. 本集團未經審核備考經調整合併有形資產淨值以及每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值並無計及為數7,700,000美元應付蜆壳電器款項撥充資本。計及撥充資本的應付蜆壳電器款項後，按[編纂]每股[編纂][編纂]港元計算，本集團未經審核備考經調整合併有形資產淨值應增至[編纂]美元。

### 無重大不利變動

除上市開支外，董事確認，直至本文件日期，本集團自2016年3月31日以來(即本集團編製最近期經審核合併財務報表日期)的財務或貿易狀況或前景概無任何重大不利變動，且自2016年3月31日以來概無任何活動將對本文件附錄一所載會計師報告所示的資料有重大影響。